

## 공동 평가 계약서

- 평가 제품명 : 300mm PE-CVD 국산화
- 평가기간: 8개월 ('02. 08. 01 ~ '03. 3. 30)
- 계약당사자:

(갑) 삼성전자 주식회사

(을) 아 토 주식회사



위 공동평가과제 수행에 관하여 (갑)과 (을)은 다음과 같이 계약을 체결한다.

### 제 1 조 (평가목표)

본 평가의 목표는 별첨1에 명시된 평가목표와 동일하다.

### 제 2 조 (평가의 수행)

(갑)과 (을)은 별첨2의 평가일정 및 역할분담에 따라 본 평가를 수행한다.

### 제 3 조 (평가 기간)

본 평가의 기간은 '02. 08.01부터 '03.37 .30까지 8개월로 한다.

단, 평가기간의 연장이 필요하다고 판단되는 경우에는 (갑)과 (을)은 서면 합의를 통하여 그 기간을 연장할 수 있다.

### 제 4 조 (평가비용)

본 계약상의 평가를 수행하기 위하여 발생하는 비용은 별첨2의 역할분담에 따라 각 사가 각각 부담한다.

### 제 5 조 (평가결과에 대한 보고, 평가, 보완)

- (1) (을)은 본 계약 기간 중 발생하는 정보 및 평가 결과 등을 (갑)에게 보고하고 (갑)은 이에 대한 평가 및 보완을 요청할 수 있다.

- (2) (갑)은 본 계약 기간中 (을)의 개발성과에 대한 평가를 실시하고, 평가 결과 중 필요한 자료를 (을)에게 제공할 수 한다.

#### 제 6 조 (기술지원 및 기술회의)

(갑)과 (을)은 본 평가의 수행을 위하여 상호간 기술정보를 제공하며, 양 사는 평가책임자를 각각 선임하여 평가수행 및 발생 문제점을 해결하기 위하여 기술회의를 소집, 필요한 정보를 교환하도록 한다.  
기술회의에 대한 일시, 안건 등 세부사항은 양사 평가 책임자가 협의하여 결정한다.

#### 제 7 조 (제공기술의 사용)

(갑)과 (을)은 본 평가의 수행을 위하여 상호 제공한 기술정보를 본 평가의 목적 외에 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 상대방의 사전 승인 없이 제3자에게 제공할 수 없다.

#### 제 8 조 (평가 결과물의 구매)

(갑)은 평가 결과물의 양산성이 있다고 판단할 경우, (을)에게 별도로 구매 요구 할 수 있고 (을)은 (갑)의 구매요구에 따라 본 평가 결과물에 대하여 최혜 납기조건으로 (갑)에게 공급하여야 하며, 구체적인 구매조건은 구매 전 상호 호혜적으로 협상한다.

단, Gas Scrubber, 연동 Valve, House gas line 작업에 필요한 공사비는 삼성에서 제공(부담)하며 Pump, Chiller와 설비 개조,개선 시 비용 모두를 Maker에서 책임지고 제공(부담)한다.

#### 제 9 조 (지적재산권의 공유)

양사는 본 계약하의 평가 결과물에 관련된 지적재산에 대해 상호간에 라이선스가 필요한 경우, 상호 합의 하에 지적재산권을 허여 할 수 있다.  
지적재산권 허 여에 따른 세부 조건은 별도의 계약을 통하여 결정되어진다.

#### 제 10 조 (신의성실 및 상호협조)

(갑)과 (을)은 신의를 가지고 본 계약의 각 조항을 성실히 이행하여야 하며, 본 평가목표의 달성을 위하여 평가내용 및 필요한 사항에 대하여 적극적으로 협의하여야 한다.

#### 제 11 조 (비밀보장)

(갑)과 (을)은 본 계약과 관련하여 획득한 비밀정보에 대하여 본 계약과 별도로 체결되는“비밀유지계약서”에 따라 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

#### 제 12 조 (계약의 기간)

본 계약 기간은 제14조에 의해 조기에 종료되지 않는 한 제3조에서 정한 평가기간 과 동일하다.

#### 제 13 조 (계약의 변경)

(갑)과 (을)은 본 계약의 내용과 별첨의 내용을 서면합의에 의하여 변경할 수 있다.

#### 제 14 조 (계약의 해지)

(1) (갑)과 (을)은 상대방이 본 계약을 중대하게 위반하였을 경우에는 2주 전에 사전 통보하여 본 계약을 해지할 수 있다.

(2) (갑)과 (을)은 평가수행이 청지상태가 되어 소기의 평가성과를 기대하기 극히 곤란하거나 완수할 능력이 없어졌다고 인정될 때 양사 합의 하에 본 계약을 해지할 수 있다.

#### 제 15조 (계약의 효력)

(1) 본 계약은 양사의 서명 일로부터 유효하다.

#### 제 16 조 (해석)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 양사의 합의에 의하여 결정한다.

#### 제 17 조 (관할)

본 계약과 관련하여 소송을 제기할 경우에는 피소자가 소재한 지역의 법원을 전속 관할로 한다.

본 계약서는 2부를 작성하여 서명 날인하고 (갑)과 (을)이 각각 1부씩 보관한다.

첨 부: 1. 평가목표 (사양)

2. 평가일정 및 역할분담

2002년 08월 12일

(갑)경기도 용인시 기흥읍 농서리 산24  
302

삼성전자 주식회사  
대표이사 이윤우

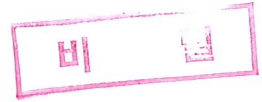


(을) 경기도 시흥시 정왕동 1263-1 2다

아토 주식회사  
대표이사 문상영







## 별첨1. 평가목표 사양

설비 사양서

### 1) SAMSUNG STANDARD 변경사양

구분	Item	Configuration	
		SEC Standard 사양	발주 사양
Auto- mation	ON-LINE Data Automation Available	HSMS(TCP/IP) / GEM Tepas (Trace data)	HSMS(TCP/IP) / GEM Tepas (Trace data)
	AGV/OHT Interface	Y	Y
	Depo Mode capability	Continues	Continues
	Wafer mapping capability	slot Dual mapping load/unload	slot Dual mapping load/unload
	Pump Interface	Process ch.(Maker: Leybold) Load lock Chamber Pump Interface.(AMAT Standard)	Process ch.(Maker: Leybold) Load lock Chamber Pump Interface.(AMAT Standard)

## 별첨 2. 평가일정 및 역할분담

### \* 평가 일정

Item	일정	담당	
		삼 성	아 토
장비 제작, 입고	~ 8/7		○
Rev.0 film 특성 평가	~9/30	○	
2000매 wafer transfer	~10/30		○
Hardware 안정성 평가	~10/30		○
공정평가	~12/30	○	
양산성 평가	~'03/03	○	

\* 역할 분담



삼성전자	아 토
1. 공정에 대한 공정 특성 및 양산성을 평가한다 2. 평가 설비의 SET-UP공간과 설비에 필요한 모든 UTILITY를 제공한다. 3. 공정평가에 필요한 TEST WAFER 및 RUN WAFER를 제공한다. 4. 공정평가에 필요한 ENG'R를 ARRANGE한다. 5. 공정평가 후 Data를 공유한다. 6. 문제점에 대한 기술정보를 제공할 수 있다. 7. 월 1회 정기 기술 회의를 가지며, 진행현황을 공유하여 적극 대처 한다. 8. Productivity Test - 생산성(Throughput) /Up time Test - MTBF/MTTR Check - PM time 및 자동화 대응력 9. Run Split Test 10.공정별 Qualification Test 11.타MAKER와 비교 평가 12.Hardware modify 작업 공유한다.	1.Hardware start up/test - 전기적,기계적 및 공학적(heating) test - Load lock base Pressure Test 2. Software start up/test 3. Temperature Controller Setup - Gas 유량변화 /Edge Effect Test - Emissivity Check 4. Temperature Control/Profile Test - Temp Uniformity/ repeatability 5. Process Setup - Applications(공정별 Recipe최적화) - Sheet Resistance 값의 변화 - Within Wafer/ Wafer To Wafer균일성 - Particle Test - Oxygen Level Check 6. Repeatability Test - Wafer Trasfer(Cycle) Test 7. Hardware 성능평가 8. Software성능 향상/수정 8.공정능력 향상 9. 설비운용에 필요한 부대설비 및 Setup 10. H/W Set up 및 Maintenance ENG'R상주 하여 공정평가 및 문제점 해결

- 7 -